



半導体ドライエッティングプロセス用ガス開発

化学（研究・開発・分析）のご経験のある方は歓迎です。

募集職種

人材紹介会社

株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント

採用企業名

非公開

求人ID

1554377

業種

電気・電子・半導体

雇用形態

正社員

勤務地

大阪府

給与

500万円～1200万円

勤務時間

08:30～17:00

休日・休暇

【有給休暇】初年度 14日 3か月目から 完全週休2日制、夏季休暇、年末年始、慶弔、育児・介護休暇制度、有給休暇：年次有給22...

更新日

2026年02月20日 21:00

応募必要条件

キャリアレベル

中途経験者レベル

英語レベル

ビジネス会話レベル

日本語レベル

ネイティブ

最終学歴

大学卒：学士号

現在のビザ

日本での就労許可が必要です

募集要項

【求人No NJB2241330】

■業務内容

半導体ドライエッティング用ガス開発としてエッティング評価および顧客への提案業務に携わっていただきます。

■具体的な担当業務

当社では、半導体デバイス製造工程におけるプロセス課題を解決できる新規ガスをエッティングレシピとセットで半導体メーカーに提案していくビジネスモデルへの転換を進めています。入社後は、これまでの経験・スキルを活かして最先端エッティング装置を用いたエッティング処理、各種分析機器を用いたプラズマ診断、SEMによる加工形状観察を実施し、プロセス条件およびプラズマ診断結果から加工形状を予測する回帰モデル構築という一連の新規ガス開発業務に従事しながら、テーマ推進、メンバーへの技術指導を行うリーダーを担っていただきます。

【使用ツール】ドライエッチング装置、プラズマ解析機器、表面分析、観察機器。

【ポジション・立場】テーママネージメント、メンバーへの技術指導を担う基幹職もしくはテーマリーダー

スキル・資格

【必須条件】以下に該当される方

- ・エッチング装置を用いた実務経験3年以上。
- ・デバイス要求を満たすエッチング条件を構築した経験を有する。
- ・エッチング装置の原理を理解し、操作することができる。

【歓迎条件】以下いずれかに該当される方（必須条件ではありません）

- ・各種測定器（断面SEM、膜厚測定器）、表面分析装置（XPS、FTIR）、プラズマ診断装置（各種プローブ、発光分光装置、質量分析計）の原理を理解し測定できる。
- ・エッチングプロセスを扱える人材を育成及び指導した経験がある。

■専攻学科

電気・電子・情報工学系

■資格

【尚可】高圧ガス製造保安責任者、特定高圧ガス取扱主任者

会社説明

ご紹介時にご案内いたします